

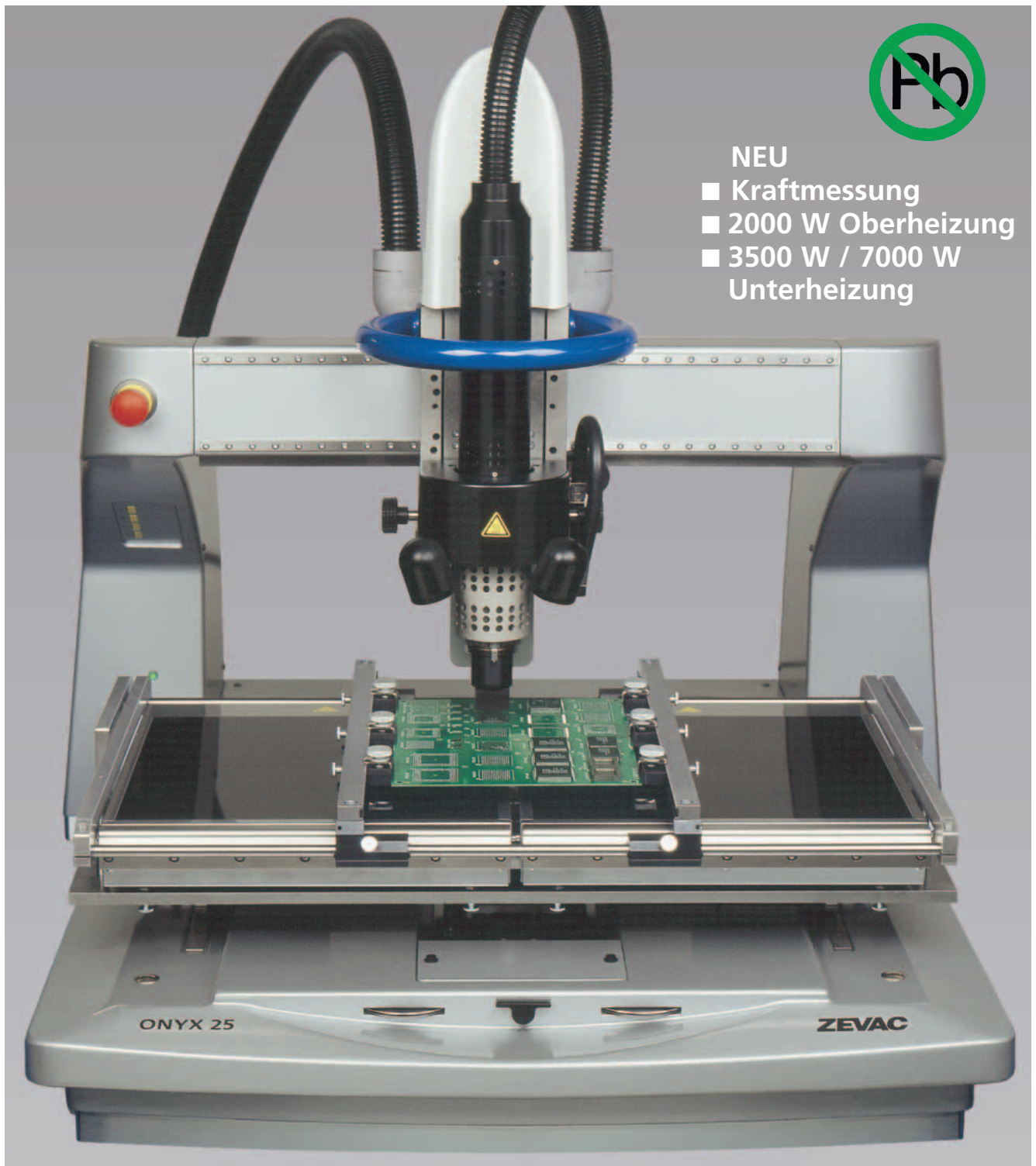
HALBAUTOMATISCHES SELEKTIVLÖTGERÄT ONYX 25

GERÄTE

4.103

**EINSATZBEREICH:** SMT**MODELLREIHE:** ONYXDie vollständige Dokumentation
der ONYX-Modellreihe besteht

aus den folgenden Datenblättern:

GERÄTE 4.101 - 4.103**ZUBEHÖR** 2.201, 2.202**OPTIONEN** 4.301 - 4.302**NEU**

- Kraftmessung
- 2000 W Oberheizung
- 3500 W / 7000 W Unterheizung

EINSATZBEREICH

ZUM SELEKTIVEN EIN- UND AUSLÖTEN VON SMD-BAUTEILEN. AUSGERÜSTET MIT EINEM SPEZIELLEN VISION-SYSTEM FÜR HÖCHSTPRÄZISE AUSRICHTUNG VON ALLEN SMD- UND FINE PITCH-BAUTEILEN, BIETET DAS ONYX 25 EIN HOHES MASS AN SICHERHEIT UND BEDIENUNGS-KOMFORT. ES EIGNET SICH VOR ALLEM FÜR:

Reparaturen

Schlecht platzierte Bauelemente können exakt positioniert, defekte Bauelemente ausgetauscht werden.

Prototypenbau

Prototypen von Leiterplatten können mit dem ONYX 25 auf rationelle Art bestückt und gelötet werden.

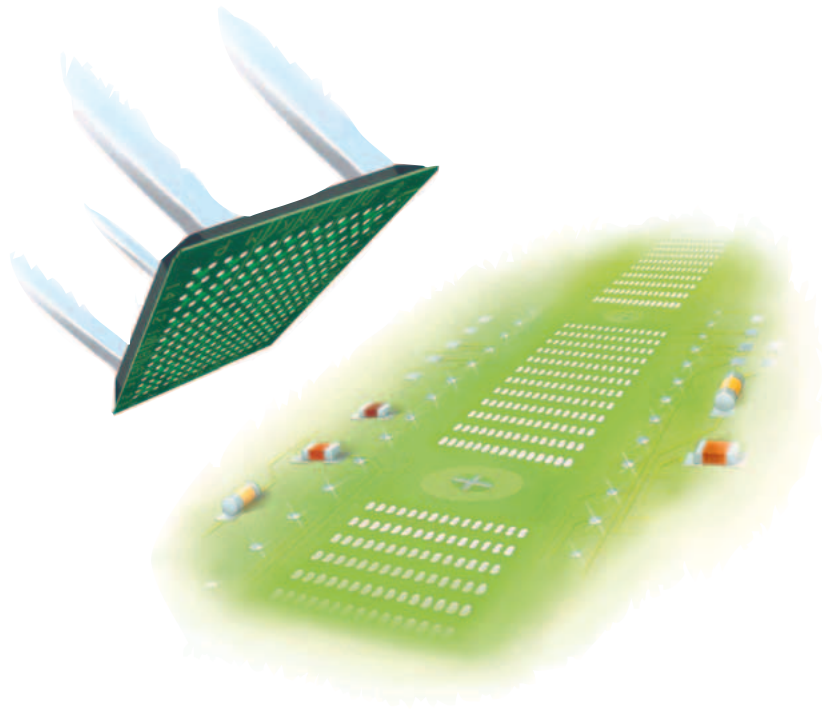
Teure Bauelemente können wiederverwendet werden.

Nachbestückung

Bauelemente, welche zur Zeit der Produktion fehlen, können nachträglich bestückt und gelötet werden. Auch einzelne Bauelemente, die mit den vorhandenen Produktionsautomaten nicht verarbeitbar sind, können nachträglich bestückt und gelötet werden.

Bestückung

Sind Leiterplatten mit nur wenigen Bauelementen zu bestücken, dann ist in vielen Fällen der Einsatz des Ein- und Auslötgerätes ONYX 25 die wirtschaftlichste Lösung.



MARKTANFORDERUNGEN

DIE RASANTE ENTWICKLUNG DER SMT FORDERT FÜR DIE HANDHABUNG EINZELNER SMD'S IMMER MEHR PROFESSIONALITÄT.

IMMER KOMPLEXERE BAUELEMENTE MÜSSEN IMMER PRÄZISER PLAZIERT WERDEN.

IMMER WERTVOLLERE LEITERPLATTEN MÜSSEN IMMER SORGFÄLTIGER BEARBEITET WERDEN.

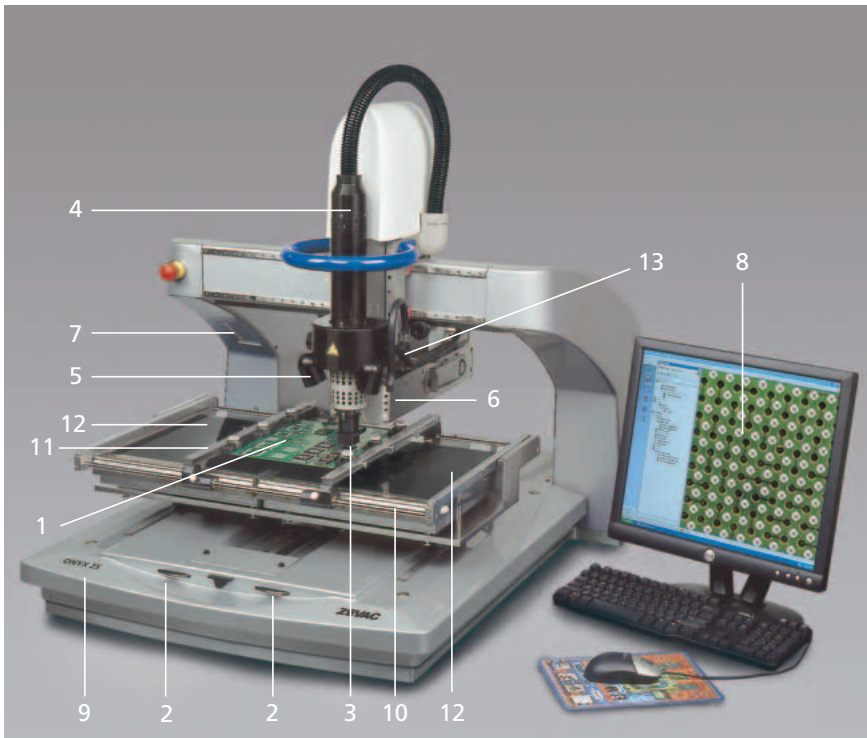
ZEVAC ONYX 25 WIRD DIESEN ANFORDERUNGEN IN BESONDERER WEISE GERECHT:

Höchste Präzision, reproduzierbare Resultate

Aufnahme der Leiterplatten und Feinverstellung in X, Y und Theta-Achse. Die Leiterplatte wird mittels mechanischer Blockierung in Position gehalten. Zentrierung des Bauelementes in der SMD-gehäusekonformen Düse. Die Düsen sind so konstruiert, dass Bauelement und Leiterplatte beim Lötprozess geschützt sind. Präzise Steuerung der Wärmemenge (Durchfluss x Temperatur x Zeit).

Bedienungskomfort, Verfügbarkeit

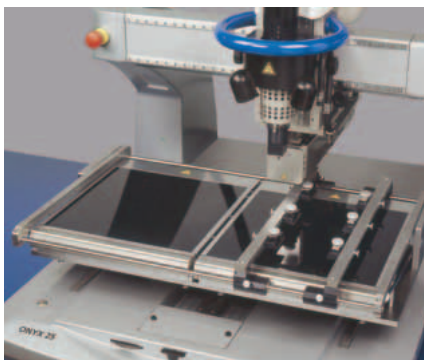
Ergonomisches Design.
Rascher, unkomplizierter Düsenwechsel.
Kurze Aufheizzeit.
Über 100 verschiedene Standard-Düsen sind ab Lager verfügbar.
Alle weiteren Sonder-Düsen sind kurzfristig lieferbar
(Zubehör-Datenblätter 2.201 + 2.202).



ONYX 25:

Hochleistungsgerät mit einzigartigem Bedienungskomfort:

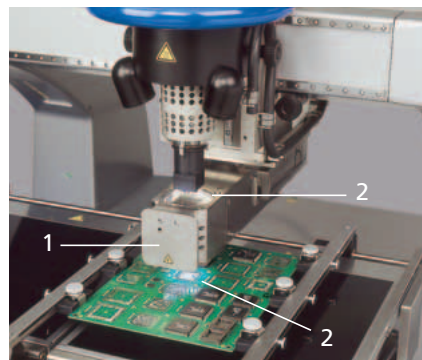
- 1 Leiterplatte
- 2 Kreuztisch mit Feineinstellung
- 3 Heissgasdüse
- 4 2000 W Oberheizung
- 5 Beleuchtung
- 6 MFOV VISION
- 7 4 Thermoelement-Anschlüsse
- 8 Flachbildschirm
- 9 Basissockel
- 10 Leiterplattenkühlung
- 11 Printhalter
- 12 Vorwärmer (optional 2. Modul erhältlich)
- 13 Heizkopfwinkelverstellung



**IR-VORWÄRMERSYSTEM
Für Bleifrei-Anwendungen**

- Einfacher Vorwärmer: 300 x 300 mm
3500 W
- Doppelter Vorwärmer: 600 x 300 mm
7000 W

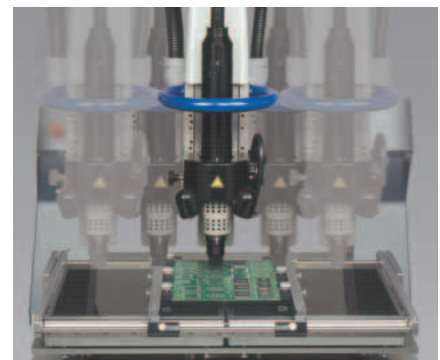
Leiterplattenkühlung als Option für schnelleres Abkühlen erhältlich.



**VISION (MFOV)
Superpräzise Positionierung
garantiert**

Durch das motorisierte Vision-System können Bauelement und Layout-konfiguration optisch übereinander gebracht und auf alle 4 Seiten ausgerichtet werden. Die LED-Beleuchtung, eine für das Bauelement und eine für die Leiterplattenoberfläche, garantiert eine optimale Sicht unabhängig von der Umgebung.

- 1 Vision-System
Für Komponenten bis 75 mm.
- 2 LED-Beleuchtung

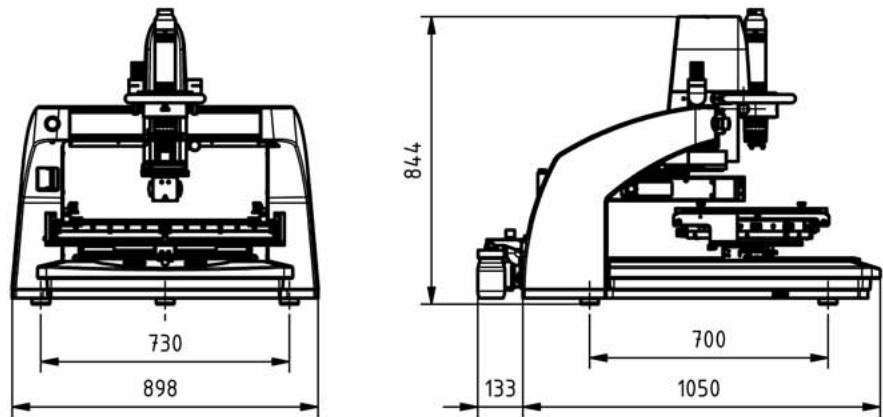


**BEWEGLICHER HEIZKOPF
Für schnelles und zuverlässiges
Lötergebnis**

Der Heizkopf kann auf jede Position der 520 mm breiten X-Achse gefahren werden. Grosse Leiterplatten können dadurch in Position bleiben und müssen nicht verrückt werden. Die optimale Position kann sehr einfach eingestellt werden. Ergonomisches und offenes Design für einfache bis zu komplexe Anwendungen.

Technische Daten	Typenbezeichnung	ONYX 25
	Max. Leiterplatten-Abmessung	520 mm (Breite), ∞ Tiefe
	Max. Bauelementhöhe	20 mm unten (30 mm als Option) 30 mm oben (70 mm als Option)
	Druckluftanschluss	4 – 6 bar 100l/min
	Heizkopfwinkelverstellung	± 10°
	Medium zur Wärmeübertragung	Gas (Druckluft, Stickstoff usw.)
	Anschlussspannung	3 x 400 / 230 VAC, 50 / 60 Hz
	Elektr. Anschlusswert	2300 W + 3500 W per preheater module
	Abmessungen (L x B x H)	1050 x 898 x 1022 mm
	Gewicht	150 kg (basic machine)
	Max. Bauelementgrösse	75 x 75 mm (grösser auf Anfrage)
	Technische Änderungen vorbehalten	

Abmessungen



Zubehör	Heissgasdüsen	Datenblatt 2.201
	Gasdüsen für BGA- und CSP-Bauelemente	Datenblatt 2.202
Optionen	Optionen - Restlotentfernung - 2. Vorwärmer 300 x 300mm - Leiterplattenkühlung - IR-Sensor - Bauelementaufnahme - Direktsicht-Kamerasystem - Lotrauchabsaugung - Maschinentisch	Datenblatt 4.302

ZEVAC - Vertretung

ZEVAC	ZEVAC AG	Telefon	+41 / 32 626 20 80
	Vogelherdstrasse 4	Fax	+41 / 32 626 20 90
	CH - 4500 Solothurn / Schweiz	E-mail	info@zevac.ch
		Website	www.zevac.ch